

放熱樹脂材料ラインナップ

Heat dissipation material lineup

特長 Features

- 大電流、高放熱、高密度化など多彩な用途に対応した基板技術を御提供。
Large current, high heat dissipation and high density technologies for various applications.
- 量産メーカーとして量産性、高信頼性を確保した技術開発を実践。
As a mass-production PCB manufacturer, we practice technological development that ensures mass productivity and high reliability.

	熱伝導率 W/m・K	膜厚 μm	BDV AC/kV	特長	ステータス
M2P	1.3	80	>6.0	UL対応・低価格	量産
M3T	3.0	70	>3.0	低価格	試作
L3TV	3.3	100	>3.0	低弾性	量産
H5T	5.0	100	>4.0	低価格	試作
H5R	6.0	120	>5.0	UL対応	量産
H8R	8.0	120	>4.0	高流動性	量産
H11T	11.2	120	>6.0	高放熱	試作
H16	16.5	150	>6.0	高放熱/UL対応	量産

材料特性マップ

